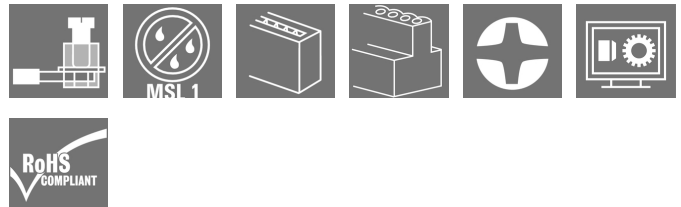


**OMNIMATE Housing - CH20M6 sorozat
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

**Az elektronika világának egy szelete**

A csak 6,1 mm vastagságú, széles választékú kompakt alkalmazások eredete ennél az elektronikai fejlesztési tapasztalatnál lehetőségre.

A modulós házkialakítás sokféle intelligens szolgáltatás tervezését támogatja:

- **A lehető legnagyobb tervezési szabadság** a nagy (6800 mm²) összfelületű NYÁK – lehetővé teszi a legnagyobb alkatrész összeállítást és a helytakarékos kialakítást a reflow-kompatibilis THR csatlakozásokkal.
- **Testre szabott kialakítási lehetőségek** lézerezéssel nyomtatott és hárszínekkkel, egyéni feldolgozási lehetőségekkel, változatos megnyomtatással, és könnyen feliratozható, csuklópántos fedéllel
- **A legnagyobb feldolgozási hatékonyság** a reflow-kompatibilis csatlakozó elemekkel a reflow forrasztáshoz a gép-kész szalagos csomagolás számára.
- **Hibamentes összeállítási és forrasztási folyamatok** optimalizált keret és csatlakozóadapter kialakításokkal a NYÁK-on, ami tökéletes illeszkedés és elhelyezést ad a csatlakozóelemek számára
- **Gyors beszerelés** a "Wire Ready" tulajdonsággal vagy a többcélú Multi-Tool csavarfejekkel

Az elektronikai fejlesztők kiváló tapasztalataival és a Weidmüller kompetenciájával - új szinergiákat készítünk az elektronikai alkalmazások számára.

Általános rendelési adatok

Típus	LHZ-SMT L 1.5SN BK RL
Rendelési szám	2418580000
Verzió	Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, Csatlakozóelem bal, blokk összeállítás, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, Pólusszám: 1, Forrasztótűske hossza (l): 1.5 mm, órozott, fekete, Tape
GTIN (EAN)	4032248984350
Menny.	432 Stück
Termékkódok	IEC: 500 V / 0.2 - 2.5 mm ² UL:
Csomagolás	Tape

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 12:26:46 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**OMNIMATE Housing - CH20M6 sorozat
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	23,5 mm	Hossz, inch	0,925 inch
Szélesség	6 mm	Szélesség (coll)	0,236 inch
Magasság	16,9 mm	Magasság (coll)	0,665 inch
Nettó tömeg	3,32 g		

Rendszer karakterisztika

Változat	Csatlakozóelem bal	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozások száma	1	NYÁK vastagsága	0,8 mm
Forrasztótűske hossza (l)	1,5 mm	Érintkező típusa NYÁK-hoz	Reflow
Érintkező - kapocs sín	Nem	Védelmi osztály	IP20

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	LCP	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	IIIa
CTI	≥ 175	Szigetelés erőssége	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező felület	ónozott	Tárolási hőmérséklet, min.	-25 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	55 °C	Max. relatív páratartalom tárolás közben	80 %
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984	Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)	13 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)	13 A	Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	500 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	320 V	Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	250 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV	Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	4 kV		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643	ETIM 6.0	EC002643
eClass 6.2	27-26-11-01	eClass 7.1	27-44-04-01
eClass 8.1	27-44-04-01	eClass 9.0	27-44-04-01
eClass 9.1	27-44-04-01		

Megjegyzések

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
----------------	--

**OMNIMATE Housing - CH20M6 sorozat
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Engineering Data

[STEP](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)

**OMNIMATE Housing - CH20M6 sorozat
LHZ-SMT L 1.5SN BK RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

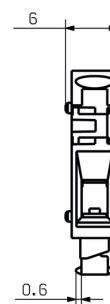
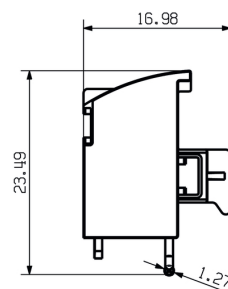
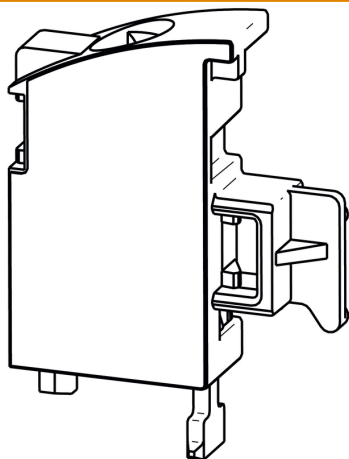
Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

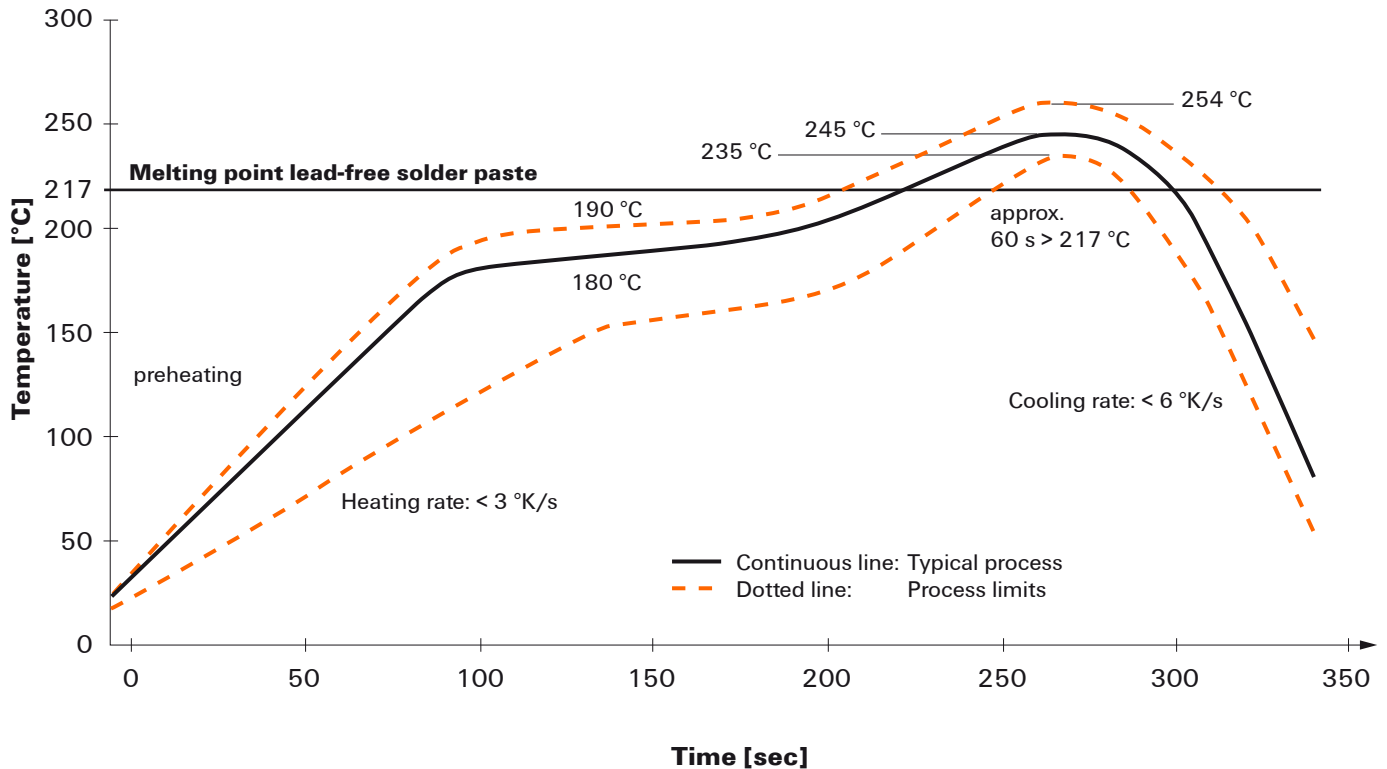
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.